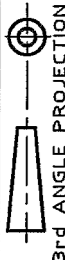


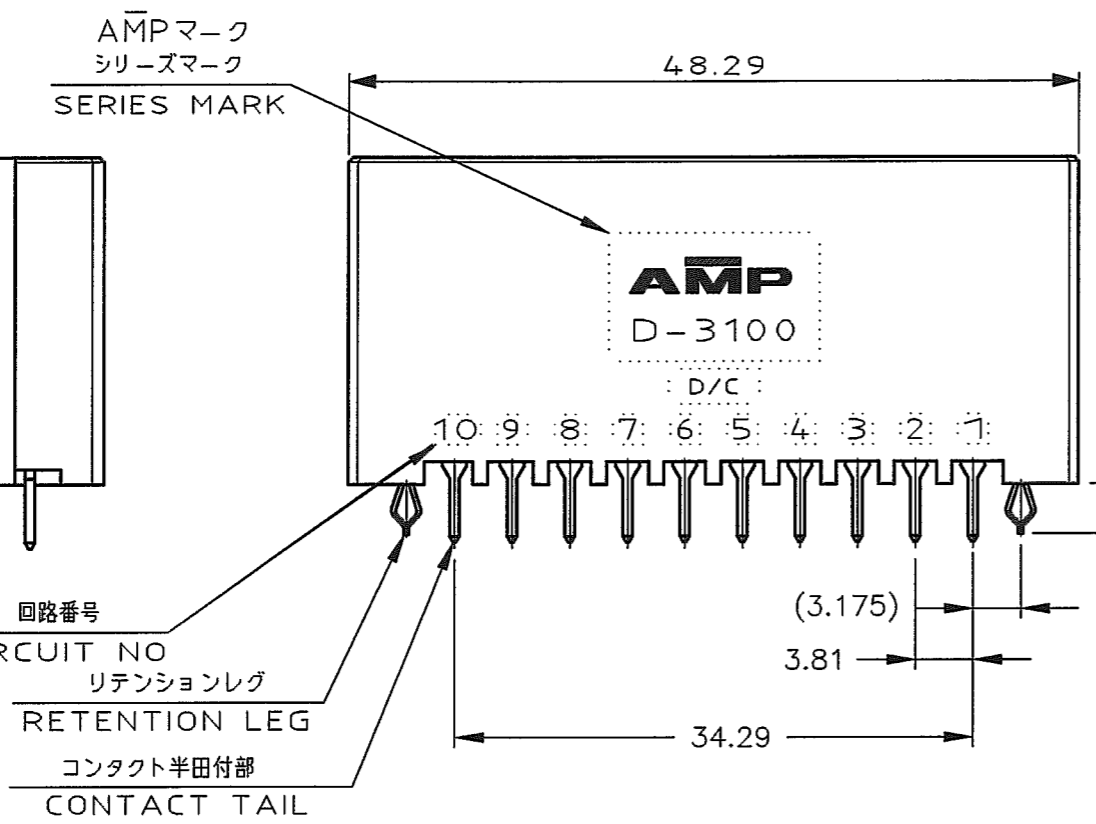
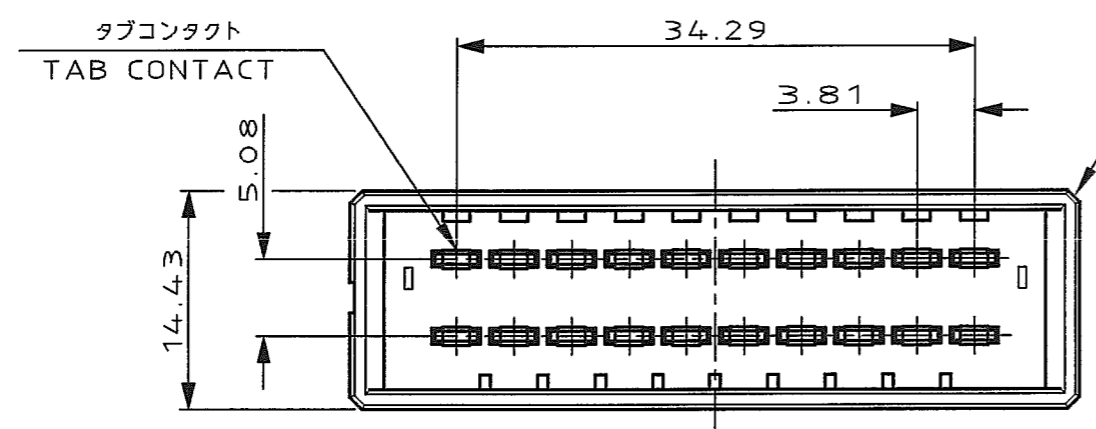
NUMBER
178328



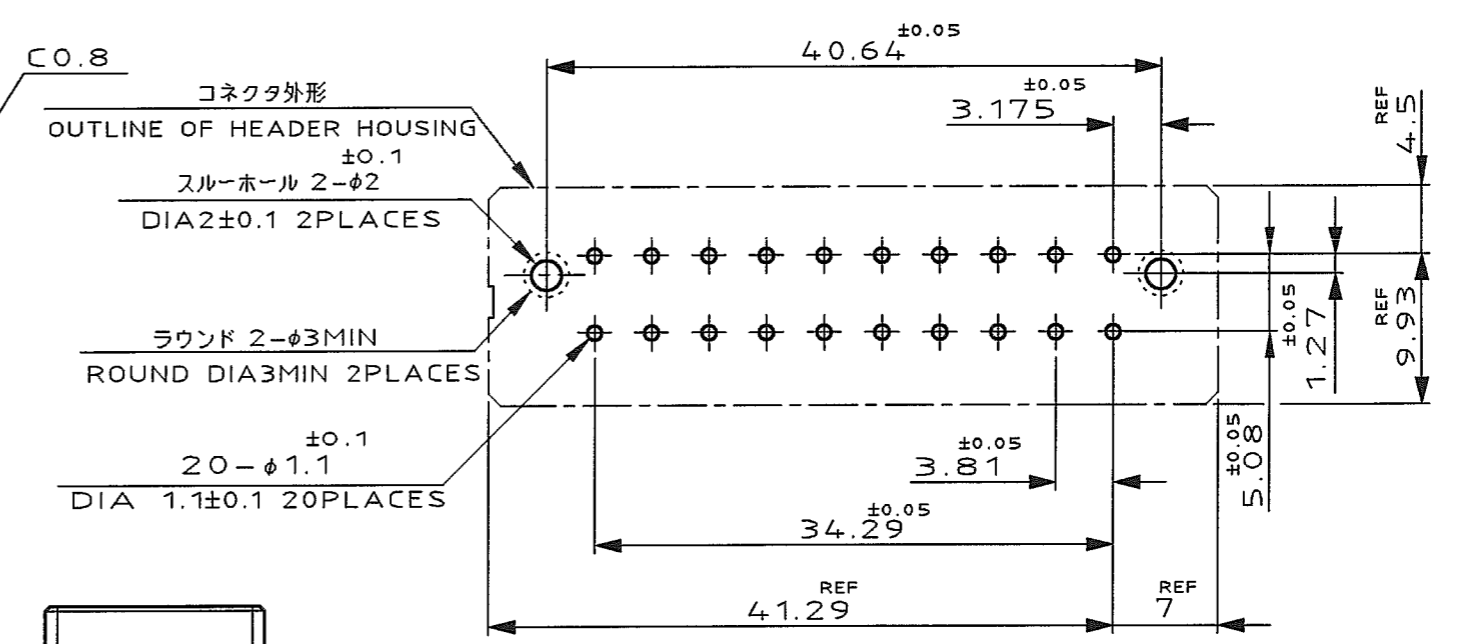
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



- △6 回路番号 CIRCUIT NO
- △6 リテンションレグ RETENTION LEG
- △6 コンタクト半田付部 CONTACT TAIL



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
 - △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒色
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	178328-5
△6	△3	178328-3
△6	△2	178328-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm²(AWG -)		mmφ		20POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		DE. 20-JAN-'93 Y. TANAKA		10mm以下: ±0.3 10mm以上30mm以下: ±0.4 30mm以上100mm以下: ±0.5 角度: ±3'	
CHK. 8-FEB-'93 S. MANABE		APP. 8-FEB-'93 S. MANABE		SIZE A3	LOC J
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		SCALE 2-1	NUMBER C-178328
D1 REVISED PER ECO-11-005030		RK HMR 23MAR11		REV. D1	SHEET 1 OF 1



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)